



(証券コード: 4973)

2016年3月期 決算説明資料



決算の概況

2016年3月期 通期の概況

電子部品業界の状況

- スマートフォンが引き続き市場を牽引しておりますが、これまで電子部品業界を下支えしてきた中国市場の成熟化や新興市場の減速に伴い成長が鈍化しました。
- 下期以降につきましては、一部ハイエンドスマートフォンの在庫調整もあり、需要が低迷しました。

当社決算の概況

- メモリ基板向けワイヤーボンディング用純金めっき薬品については、汎用スマートフォン需要が増大し増加に転じました。
しかし、パソコンやサーバー向け金めっき薬品については、前期に続き金の薄膜化の影響を受けて減少しました。
- ハイエンドスマートフォン向けや車載向けマイクロコネクタ用硬質金めっき薬品は在庫調整の影響を受けたものの、技術的な優位性から概ね順調に推移しました。
- フレキシブル基板向けの金めっき薬品は電解めっきから無電解めっきへの仕様変更の流れを受けて省金化が進み、電解めっき薬品の販売は減少しましたが、無電解めっき薬品の需要が増加しております。

2016年3月期 決算概況

(単位：百万円、%)

決算期	2015/3期	2016/3期						2016/3期予想	
		1Q	2Q	3Q	4Q	通期合計	増減率	※	達成率
売上高	9,556	2,528	2,077	2,053	1,770	8,429	-11.8	8,700	96.9
営業利益	1,109	264	254	251	186	957	-13.7	1,000	95.8
経常利益	1,176	308	256	296	186	1,047	-10.9	1,100	95.3
純利益	768	212	173	205	116	708	-7.8	750	94.4
1株当たり 当期純利益※1	131.87円	36.47円	29.73円	35.13円	20.00円	121.31円	-8.0	128.40円	94.5

※ 2016年1月27日付で業績予想を修正しております。

Historical metal prices

メタル相場推移

Prices of copper, nickel and tin

銅、ニッケル、スズ価格

Price of gold, palladium

金(ゴールド)、パラジウム価格

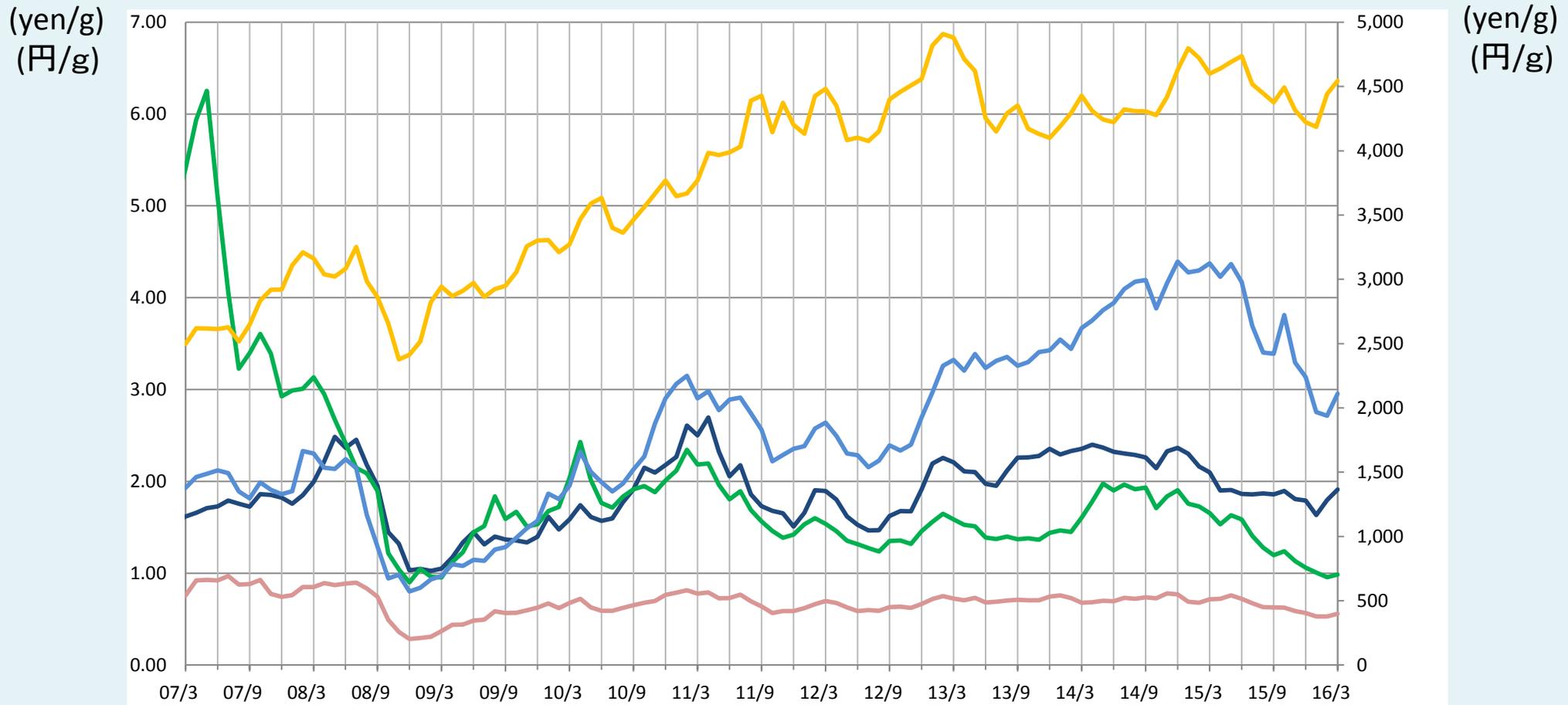
Copper
銅

Tin
スズ

Nickel
ニッケル

Gold
金

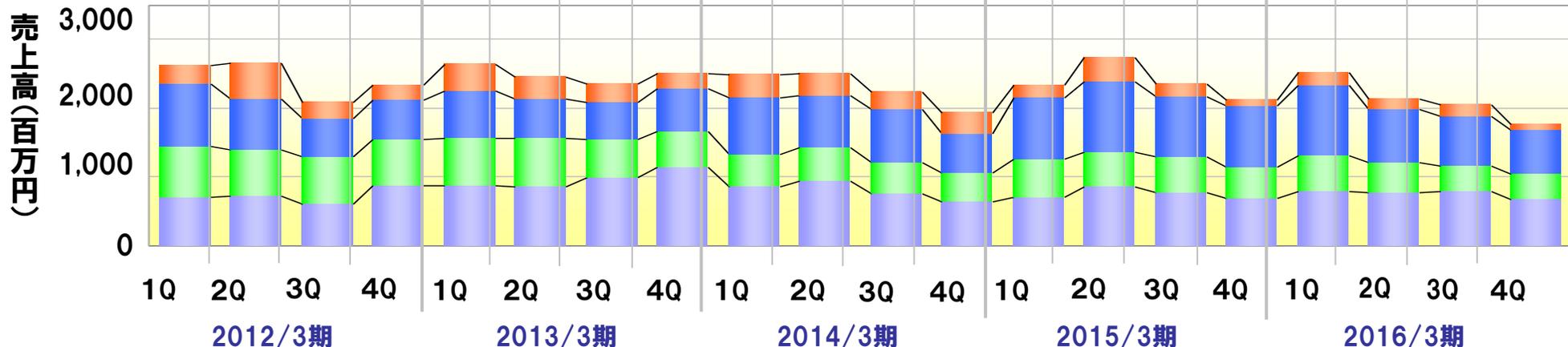
Palladium
パラジウム



用途品目別および地域別売上高の推移

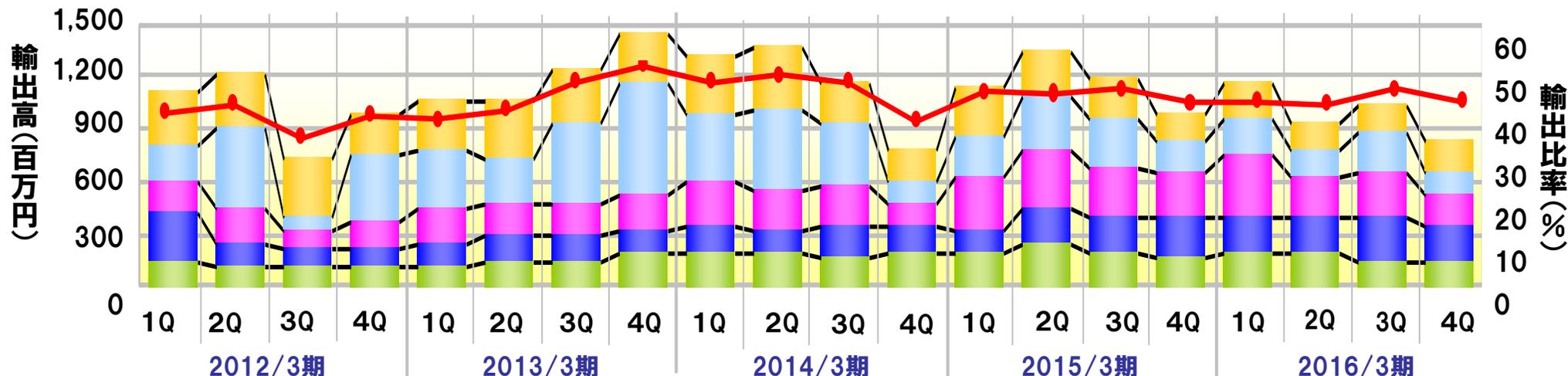
用途品目別売上高の推移

- プリント基板・半導体搭載基板用
- コネクタ・マイクロスイッチ用
- リードフレーム用
- その他

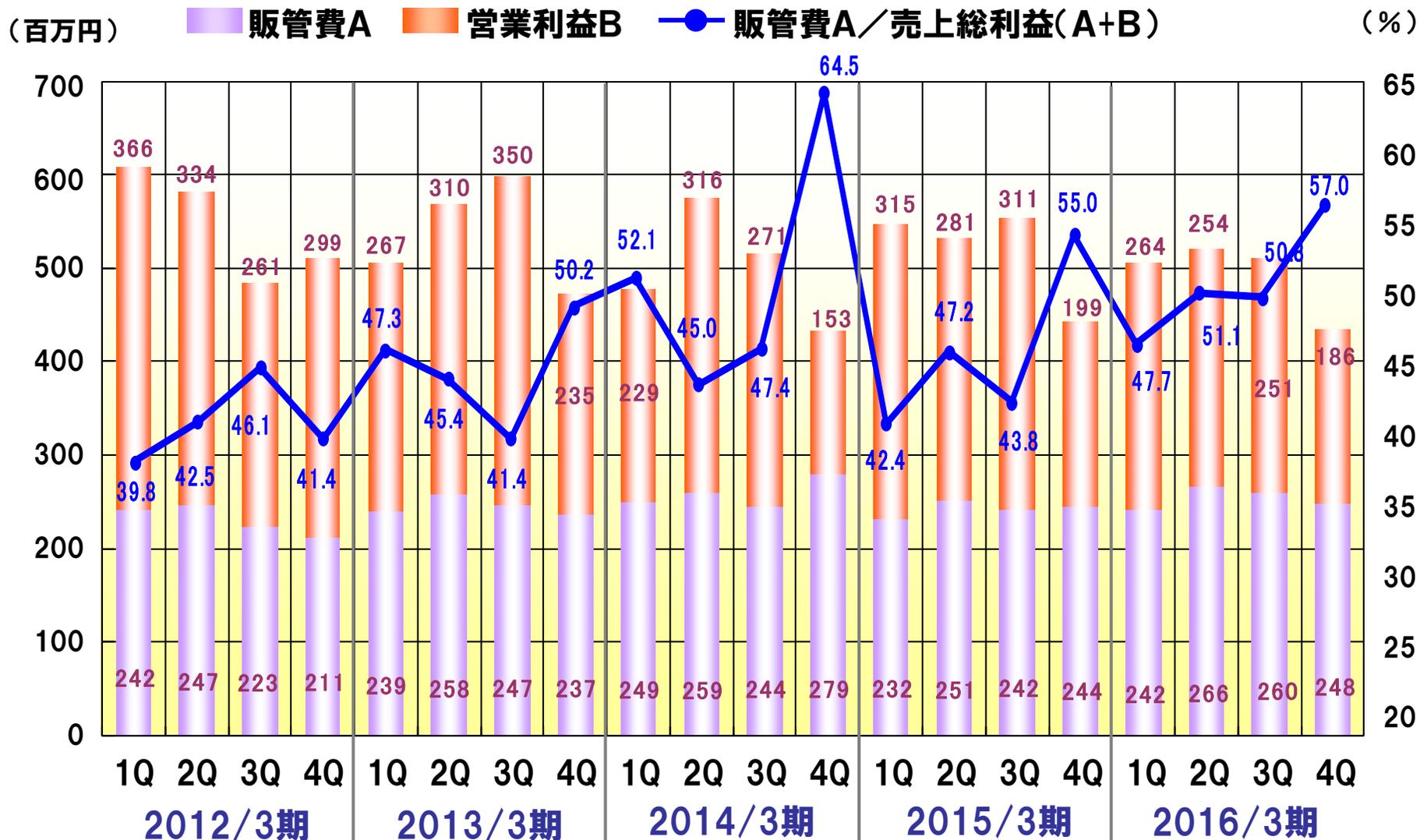


地域別(輸出)売上高の推移

- 台湾
- 韓国
- シンガポール・マレーシア
- 輸出比率
- その他
- 中国



販売管理費および営業利益の推移



株主還元について

■一株当たり配当金

(単位:円、%)

	通期	EPS ※	配当性向
2012/3期	8,000	114.37	70.0
2013/3期	8,000	134.20	59.4
2014/3期	8,000	114.80	69.5
2015/3期	80	131.87	60.7
2016/3期	80	121.31	65.9

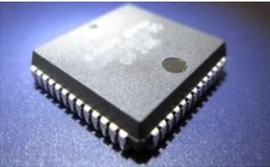
※ 2014年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
そのため、当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益を算定しております。

2017年3月期 業績見通し

(単位:百万円、%)

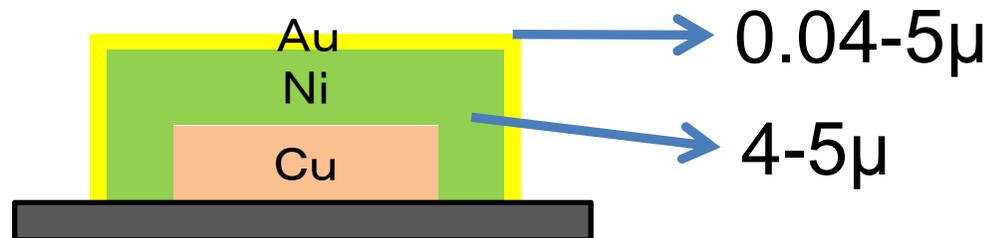
決 算 期	2016/3期 第2四半期	2016/3期 通期	2017/3期 第2四半期		2017/3期 通期	
	実績	実績	予想	前年比	予想	前年比
売 上 高	4,605	8,429	4,400	▲4.5	8,900	5.6
営 業 利 益	518	957	520	0.2	1,100	14.9
経 常 利 益	564	1,047	570	0.9	1,190	13.6
当 期 純 利 益	386	708	400	3.5	830	17.2
1株当たり当期純利益	66.21	121.31円	68.48	3.4	142.09	17.1

製品ラインアップと薄膜化・フレキシブル基板対応

めっき方式		用途	製品ラインアップ
電解	純金 (99.99%以上)		TEMPERESISTシリーズ (厚膜めっき) ICパッケージのはんだ接続、ワイヤーボンディング用 EX フレキシブル基板対応 FX
	硬質金 (金合金)		OROBRIGHTシリーズ (局所めっき) コネクタ、フレキシブル基板の接続用 HS (Co合金) マイクロコネクタ対応 BAR7 (Co合金)、BAR (Ni) (Ni合金)
	電解Pd		PALLABRIGHTシリーズ (薄膜めっき) リードフレーム用 SST-L PPF薄膜化対応 NANO2
無電解	置換金		IM-GOLDシリーズ (薄膜めっき) フレキシブル基板用途拡大 PC、FG スマートフォン対応 IB2、CN-I、IB2X、OM2
	還元金		NEO GOLD (厚膜) から HY-GOLD (薄膜) へ サーバーやデスクトップPC向け MPUパッケージ用 NEO GOLD、HY-GOLD
	還元Pd		NEO PALLABRIGHTシリーズ (薄膜めっき) スマートフォン等のCSPパッケージ用 ネオパラブライต์、ネオパラブライต์2

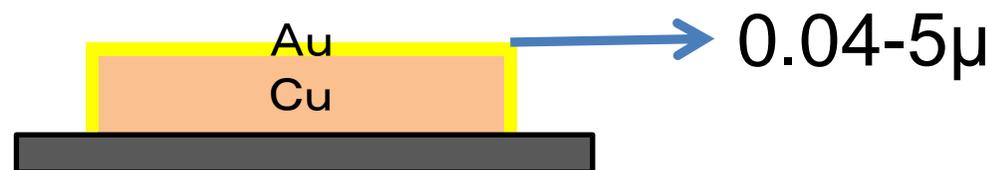
ダイレクト無電解金めっき Direct Immersion Gold (DIG)

Electroless Ni and Immersion Gold (ENIG)

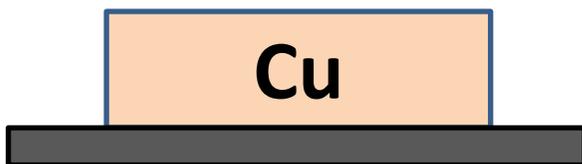


- ・解像力・高周波特性に限界
- ・コスト高
- ・曲げるとクラックが入る
- ・加熱に強い

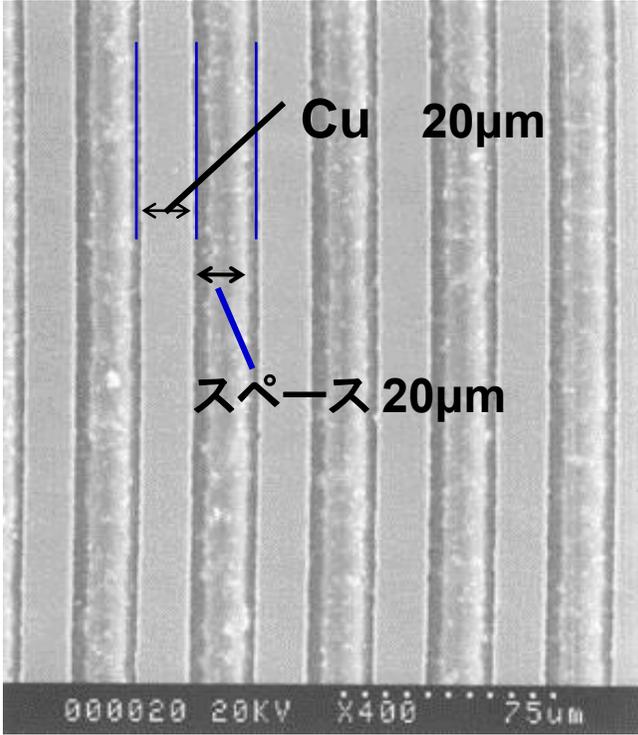
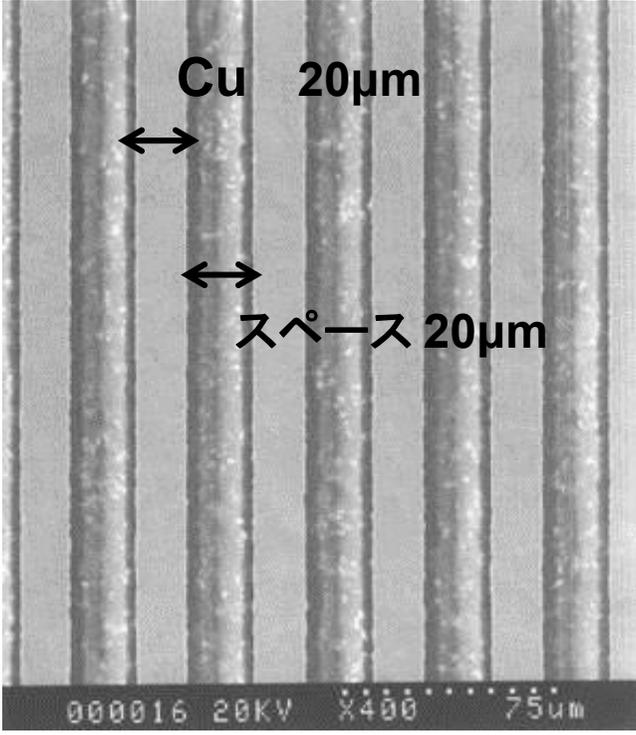
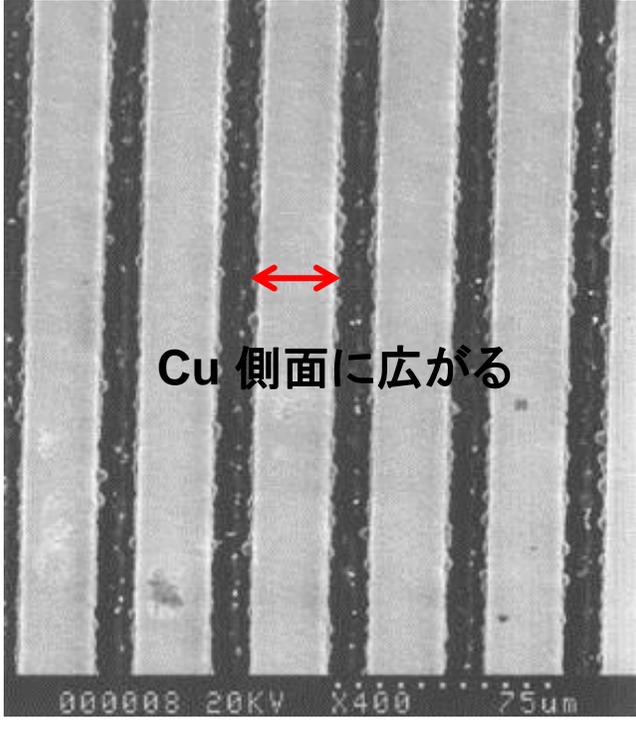
Direct Immersion Gold (DIG)



- ・解像力・高周波特性良好
- ・クラック耐性良好
- ・コスト削減
- ・加熱に弱い



DIGとENIG ファインパターンへの追従性

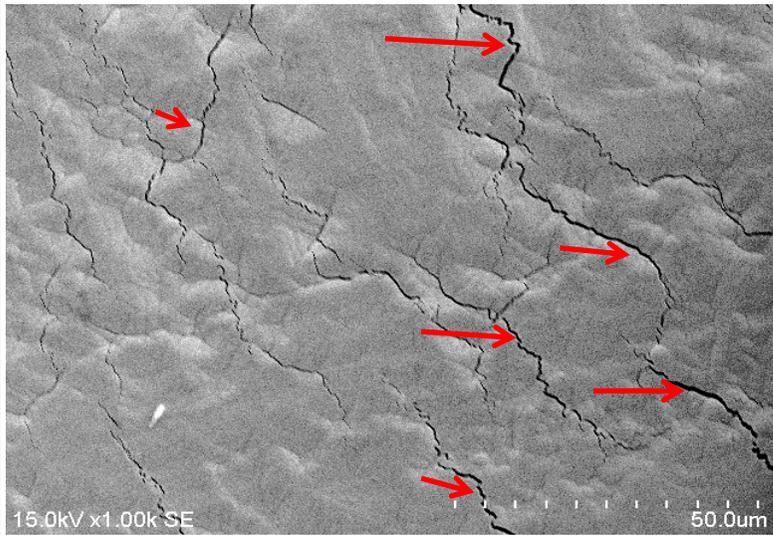
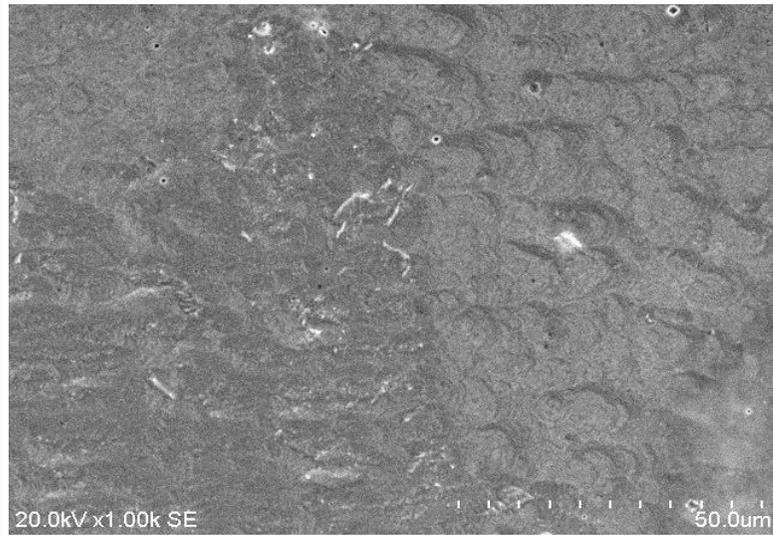
テスト基板(未処理)	DIGめっき後	ENIGめっき後
Cu	Au0.06 μ m / Cu	Au0.06 μ m / Ni-P5 μ m / Cu
 <p>Cu 20μm</p> <p>スペース 20μm</p> <p>000020 20KV X400 75μm</p>	 <p>Cu 20μm</p> <p>スペース 20μm</p> <p>000016 20KV X400 75μm</p>	 <p>Cu 側面に広がる</p> <p>000008 20KV X400 75μm</p>

✓ **ENIG** はめっき厚並みに横にも広がり、ファインパターン追従不可能

✓ **DIG** めっきはファインパターンに追従可能

ENIGとDIG 屈曲性比較

銅箔が貼付けられたフィルムを各々ENIG、DIGめっきした後
1mm径の丸棒に巻きつけ、めっき表面のクラック発生を比較

水準	ENIG	DIG
皮膜	Cu / Ni-P 4um / Au 0.05um	Cu / Au 0.06um
結果	クラック発生	クラック無し
		

ENIGのクラック発生は**DIG**に変更すれば解消

注意事項・免責事項

当該資料で用いられている業績予想ならびに将来予測は、いずれも当社の事業に関連する業界の動向についての見通し、国内および諸外国の経済状況、ならびに為替レートの変動、その他の業績へ影響を与える要因について、2016年3月時点で入手可能な情報をもとにした予想を前提としています。

これらは、市況、競争状況、新製品およびサービスの導入およびその成否、ならびに情報通信関連産業の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。よって、実際の業績は配布資料および決算説明で用いる予想数値とは、大きく異なる場合があることをご了解いただきますようお願い致します。

この資料の著作権は日本高純度化学株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可なく資料を複製・配布することを禁じます。

お問い合わせ先

TEL. 03-3550-1048 FAX. 03-3550-1006

経営企画部

ir@netjpc.com <http://www.netjpc.com>